**財團法人台灣設計研究院**

**附件二**

**個人資料蒐集、處理及利用同意書**

財團法人台灣設計研究院(以下簡稱本院)為執行經濟部工業局委辦111年設計驅動跨域整合創新計畫，並將蒐集、處理及利用您的個人資料，謹依據個人資料保護法(以下簡稱個資法)告知下列事項：

一、蒐集目的：本院依「個資法之特定目的及個人資料之類別」內「第69類-契約、類似契約或其他法律關係事務」與「第172類-其他公共部門（包括行政法人、政府捐助財團法人及其他公法人）執行相關業務」之目的，蒐集、處理及利用您的個人資料。

二、資料類別：自然人之姓名、職業、聯絡方式(包括但不限於電話號碼、E-mail、居住或工作地址)、其他得以直接或間接方式識別該個人之資料。(註:實際蒐集狀況請再修改本條內容文字)

三、利用期間：自111年6月15日開始，以合理方式利用至蒐集目的消失為止。

四、利用地區：除蒐集之目的涉及國際業務或活動外，僅於中華民國領域內利用您的個人資料。

五、利用對象：本院與經濟部工業局。

六、利用方式：在不違反蒐集目的前提下，以網際網路、電子郵件、書面、傳真、國際傳輸行為及其他合法方式利用之。

七、當事人權利：您可依個人資料保護法第3條規定，就您的個人資料進行以下權利，如欲行使以下權利，請洽主執行單位專請洽本院專線(02)2745-8199#542或來信至以下hsunting\_liu@tdri.org.tw。

1. 查詢或請求閱覽

2. 請求製給複製本

3. 請求補充或更正

4. 請求停止蒐集、處理或利用

5. 請求刪除您的個人資料。

八、不提供個人資料之權益影響：若您未提供正確資訊或拒提供個資，本院將無法為您提供本計畫之相關服務。

九、本院因業務需要而委託其他單位處理您的個人資料時，將善盡監督之責。

十、您已瞭解本同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，並同意本院留存紙本以利查驗。

**個人資料之同意提供：**

一、本人已充分獲知且已瞭解上述告知事項。

二、本人同意於所列蒐集目的之必要範圍內，蒐集、處理及利用本人之個人資料。

**學校/科系：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**立書人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (簽名)**

**聯絡電話：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

中 華 民 國 年 月 日